

2025 年度第 2 四半期決算説明会（2025 年 10 月 31 日開催）

QA 要旨

Q1. 2Q の製品売上原価率が前四半期よりかなり上昇しましたが、その要因として新規量産品の立上げ時の影響の説明がありました。今回通期予想を下方修正した主な要因は、この新規量産品の影響が大きいと思いますが、2Q だけを見た時は、従来の中国通信機器向け製品の出荷が 1Q から 2Q へ後ろ倒しになった影響もありますか。

A1. 今期の通期予想の営業利益を下方修正した要因は、新規量産品の立上げ時の製品売上原価率悪化の影響及び先行開発費の増加が要因ですが、その製品売上原価率悪化の影響は、3Q に最も大きく出て、4Q も影響が残る見込みです。1Q から 2Q にかけて製品売上原価率が悪化した要因は、新規量産品の立上げ時の影響及び中国通信機器向け製品の出荷が 1Q から 2Q へ後ろ倒しになったことによる影響の両方が影響しています。

Q2. 2Q から 3Q にかけて製品売上原価率はどう変化しますか。

A2. 2Q から 3Q にかけて新規量産品の製品売上原価率の改善は見込んでいますが、当初予想を上回る数量増加の影響等により、3Q の全体の製品売上原価率は 2Q より高くなると見えています。

Q3. 貴社はこれまで製品売上原価率 60%、製品売上粗利率 40%を基本的なベースとしていたとの説明でしたが、来期以降はその水準に戻していけると考えていますか。

A3. 今後も製品売上原価率 60%、製品売上粗利率 40%が基本ターゲットだと考えています。ただ短期的には、新規量産品の立上げや製品構成の変化等によりますが、ターゲットの水準に戻すのは難しく、概ね 60%台半ばとなる可能性があります。ただ、今後の見通しや中期的な目標（Medium-Term Targets）には、この状況をある程度織り込んでいます。

Q4. 研究開発費について、今期は当初予想を上回り積極的な投資を行うとのことでしたが、来期も更に増加する見通しですか。

A4. 来期もその傾向が続く可能性があります。これはチップレット時代に、オープンでフレキシブルな使いやすいチップレットの設計開発の環境を準備する等、積極的に投資をしていくためです。特定の商談への対応というより、中長期的な成長の布石で、将来的な競争力を確保するための重要な取組みと考えています。

Q5. 今期直面している新規量産品の急速な立上げによる原価率悪化の影響について、来期も大型商談の量産立上げが予定されていると思いますが、今期と同様の影響は出るのでしょうか。また今期の教訓をどう生かしていこうと考えていますか。

A5. まず量産前の段階でも、テープアウトしてから ES（エンジニアリングサンプル）を出して、評価、検証、そして改善への期間をいかに短くするかが重要だと考えています。また、大型商談の量産立上げにあたっては、初期からの需要が大きくなるという想定で歩留り改善等の原価率改善のスピードアップを図り、テスト体制も早期に準備していきたいと思います。

Q6. 今期立上げの新規量産品について、搭載車種が増えることでライフタイムでの数量見通しもさらに拡大しているのでしょうか。

A6. このお客様の具体的なフォーキャストについては、来年半ばぐらいまでしか出ていませんが、さらなる数量の拡大を期待しています。ただ、ライフサイクルは、従来の自動車向け商談は平均的には 5～7 年でしたが、今後は特に ADAS、HPC の分野では、それより短くなると見えています。

Q7. 来期量産立上げ予定のデータセンター向け大型商談の設計・開発は順調に進捗していますか。

A7. 2Q 中にテープアウトを完了し、概ね予定通りに進捗しています。見通しにも特に変化はなく、来年度後半からの売上貢献を期待しています。

Q8. データセンター向けの大型商談は、売上規模が大きい一方で、利益を確保するのが難しいという懸念がありますが、貴社が獲得した商談は利益率が一定程度確保できる価格設定になっているのでしょうか。

A8. 最近の大型商談のグロスマージンは、従来から構造的にも低い水準になる傾向があります。ただ今後の見通しや中期目標の策定にはこの状況を織り込んでいます。また、今期の経験を生かして、量産立上げ時の原価率改善を着実に行って、早期に利益貢献もしていきたいと思います。

Q9. 新規量産品の立上げに伴うテスト体制の準備について、今回発生したコストは一時的な設備投資と考えてよいのでしょうか。それとも、新規量産立上げの度に都度発生するものなのでしょうか。また、準備したものは他の製品にも転用できるのでしょうか。

A9. テスト体制準備のコストは、設備投資と一時的費用の両方の側面があります。テスト装置も OSAT（製造委託先）側で投資する場合と当社で準備が必要な場合もあります。テスト装置については、他の製品に使えるものもあります。また、テストについては製品の最適な品質を維持しながら、テスト時間を短縮していく技術的な改善も重要で、量産立上げ時の原

価率改善にも影響があります。

Q10. 今期の新規商談獲得の状況について教えてください。上期を終えて、今期の目標に対して進捗はどうだったのでしょうか。

A10. 現時点で今期の商談獲得金額について申し上げるのはまだ早いと思いますが、昨年度の水準を目指して、データセンター向けと自動車向けをバランスよく獲得していきたいと考えています。

Q11. 現在、設計・開発中のデータセンター向けの製品について、テープアウトが完了した段階で、他の新たなお客様を含めて売上が拡大していくことを期待している、との説明がありましたが、これは特定のお客様向けに設計されたものを、他のお客様にも横展開していくということでしょうか。

A11. 現在、設計・開発中のデータセンター向けの製品は CPU なので、パートナー企業を含めて、その可能性はあると思っています。ただそういう可能性も、テープアウトが完了してから各種のテストプロセスや ES（エンジニアリングサンプル）のプロセスを経た段階でないと判断できないと思いますので、見極めるにはもう少し時間がかかると思います。

Q12. 今回リリースされた"Flexlets"について、どういったアプリケーションをターゲットにして、タイムラインはどのように見れば良いのでしょうか。

A12. 従来のモノリシック SoC は、レチクルサイズの制約、歩留まりの問題、熱設計におけるボトルネックといった物理面および経済面の限界に直面しており、業界はこれらの課題に対する解としてチップレットベースの設計へと移行しつつあります。ただ現状提供されているチップレットの多くは機能が固定された ASSP（特定用途向け標準製品）向けを前提に設計されており、設計の柔軟性やカスタマイズ性に制約があります。当社は、RTL レベルでカスタマイズ可能なチップレット設計ライブラリー「Flexlets」を提供することで、こうした課題を克服します。Flexlets は従来のアプローチと異なり、高性能コンピューティング、先進的なネットワーキング、次世代の車載システムといった先進のアプリケーションにおいて、顧客独自のニーズに応じて性能を最適化できる柔軟性を提供します。当社では Flexlets ベース設計による最初のエンジニアリングサンプル（KGD = Known Good Die の提供を含みます）を現在開発中であり、2025 年中に最初の顧客向け製品の設計を開始、2026 年第 2 四半期（4 月～6 月）よりさらに案件の拡大を予定しています。

Q13. 今期の NRE 売上について、前年比でもマイナスとなっており、先端製品の比率が大きく伸びているにもかかわらず、伸びていないのは何故ですか。計上のタイミングの問題ですか。

A13. 今期は、下期の方が NRE 売上の計上が多いと見込んでおり、特に 4Q は複数の製品のテープアウトが予定されているので NRE 売上が大きくなると見えています。年度を通して見ると、実質ベースでは微増かと思っています。

Q14. 新規量産品の立上げのコストについて、お客様の要求で当初予想を上回る数量となりコストが増加したのであれば、価格転嫁など、お客様にそのコストの増加分を負担してもらうことはできないのでしょうか。

A14. 当社は、お客様の市場での競争に貢献できるよう、急な需要拡大にもできるだけ対応したいと考えています。これを前提としてお客様のご理解、ご協力も得たいと考えています。また、価格設定にあたっては、ボリュームだけの価格設定ではなく時間軸も加味するなど、今後の課題として検討する必要があると考えています。

Q15. 今回、通期予想（営業利益）を下方修正しましたが、昨年度のような在庫調整等の需要の減少が、その要因ではないと思います。今期の下期から来年度に向けて、足元の需要を見た時に、伸びている分野など需要環境に変化は見られますか。

A15. 今期自動車向け売上は大きく伸びる見通しですが、これは個別商談の量産立上げによるもので、マクロの車載需要の動きとは異なります。

需要全体を見ると、期初予想から大きく変化しているところはないと思います。昨今の AI 需要の拡大で、計測機器向けなど一部の既存製品での増加はみられますが、全体に占める比率はさほど大きくありません。自動車やデータセンターネットワーク分野以外のスマートデバイスや産業機器分野向けの受注も、在庫調整が終わり実需に沿った受注状況となり、堅調に推移するものと見えています。

以上